

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2024年1月4日(04.01.2024)



(10) 国際公開番号

WO 2024/005149 A1

- (51) 国際特許分類:
C08G 59/20 (2006.01) H01B 1/22 (2006.01)
C08L 63/00 (2006.01) C08K 3/08 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2023/024208
- (22) 国際出願日: 2023年6月29日(29.06.2023)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2022-105366 2022年6月30日(30.06.2022) JP
- (71) 出願人: 株式会社スリーボンド(THREEBOND CO., LTD.) [JP/JP]; 〒1920398 東京都八王子市南大沢四丁目3番地3 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 遠藤 悟(ENDO, Satoru); 〒1920398 東京都八王子市南大沢四丁目3番地3 株式会社スリーボンド内 Tokyo (JP). 根本 崇(NEMOTO, Takashi); 〒1920398 東京都八王子市南大沢四丁目3番地3 株式会社スリーボンド内 Tokyo (JP). 鈴木 崇史(SUZUKI, Takashi); 〒1920398 東京都八王子市南大沢四丁目3番地3 株式会社スリーボンド内 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: I B C 一番町弁理士法人(IBC); 〒1020082 東京都千代田区一番町10番地2 Tokyo (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
- 添付公開書類:
一 国際調査報告(条約第21条(3))

(54) Title: CONDUCTIVE RESIN COMPOSITION

(54) 発明の名称: 導電性樹脂組成物

(57) Abstract: Provided according to the present disclosure is a conductive resin composition that suppresses generation of outgas. The present disclosure relates to a conductive resin composition containing the following components (A)-(D). Component (A): bisphenol epoxy resin, component (B): epoxy resin having a boiling point of 300°C or higher (excluding component (A)), component (C): conductive particles, component (D): epoxy resin curing agent

(57) 要約: 本開示によれば、アウトガスの発生を抑制した導電性樹脂組成物が提供される。本開示は、下記の(A)～(D)成分を含む、導電性樹脂組成物に関する。(A)成分: ビスフェノール型エポキシ樹脂 (B)成分: 沸点が300℃以上のエポキシ樹脂 (A)成分を除く (C)成分: 導電性粒子 (D)成分: エポキシ樹脂硬化剤



WO 2024/005149 A1